

## 拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願 2000-297670
起案日	平成16年 6月 2日
特許庁審査官	大嶋 洋一 9170 4L00
特許出願人代理人	鈴江 武彦 (外 6名) 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

## 理 由

16.8.-7

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

<請求項1～3, 5～7, 9について>

- ・理由 1, 2
- ・引用文献 1
- ・備考

引用文献1の、特に第1, 2, 3, 6図及びその説明箇所を参考のこと。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

## 引 用 文 献 等 一 覧

1. 特開平10-027799号公報
-

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野     I P C 第 7 版  
H 0 1 L 2 1 / 8 2 , H 0 1 L 2 1 / 8 2 2  
H 0 1 L 2 7 / 0 4 , H 0 1 L 2 1 / 3 2 0 5  
H 0 1 L 2 1 / 3 2 1 3  
H 0 1 L 2 1 / 7 6 8  
H 0 1 L 2 1 / 2 8 - H 0 1 L 2 1 / 2 8 8  
H 0 1 L 2 9 / 4 0 - H 0 1 L 2 9 / 5 1  
G 0 6 F 1 7 / 5 0

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

＜参考情報＞

今回の拒絶理由において、各引用文献、先行技術文献等の、主にどのような技術的ポイントに着目しているかについて、参考情報として示します。意見書・補正書作成の際、参考情報としてご利用ください。

ただし、下記ポイントは、引用文献の一部の記載について例示的に示したに過ぎず、拒絶理由の対象となる範囲は、この記載に限定されず、あくまでも引用文献に記載された全範囲である点について、留意してください。

引用文献 1：上層配線よりも膜厚が厚く、ピッチの広い下層配線を有する多層配線の構成。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ(例：引用文献の番号違い等)、または技術説明等の面接の御希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第三部 半導体集積回路

審査官 大嶋 洋一

TEL. 03 (3581) 1101 内線3498

FAX. 03 (3501) 0673